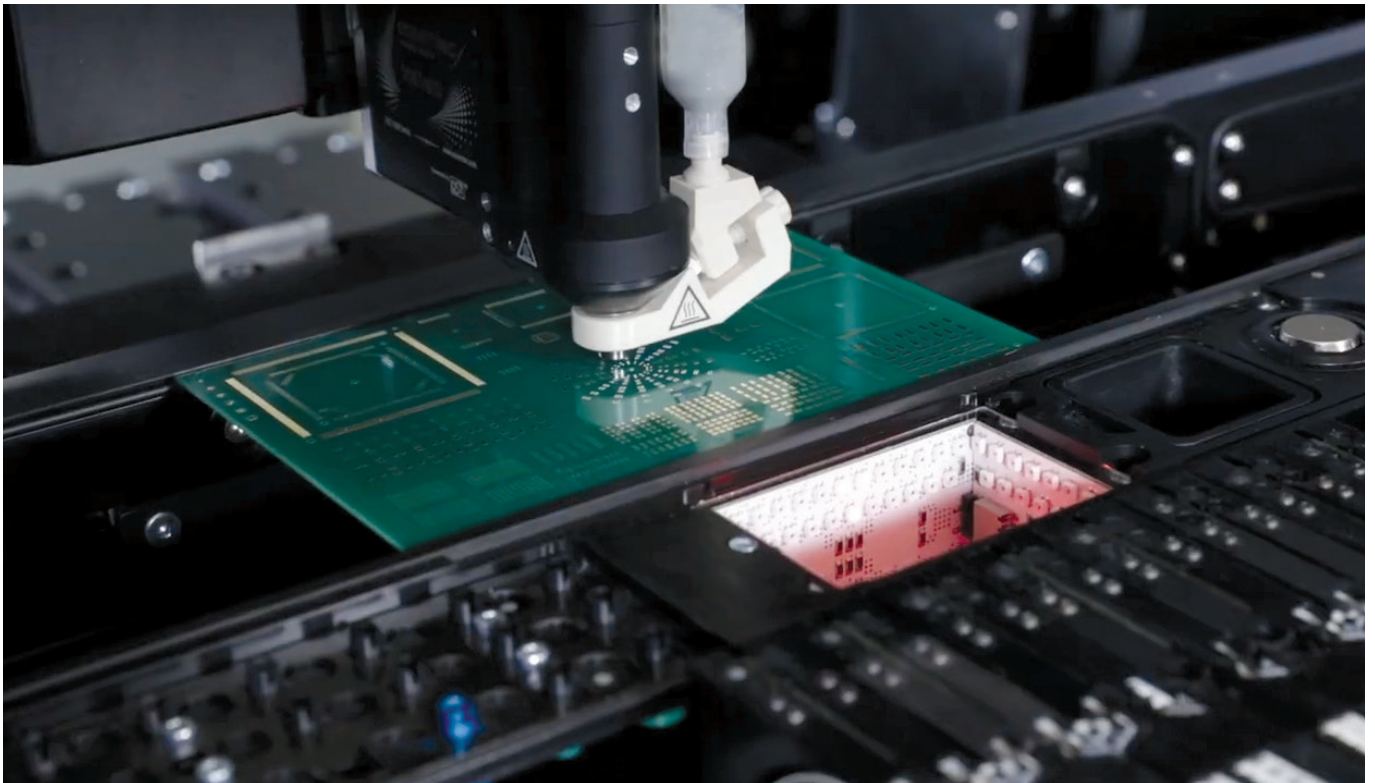


NEWSLETTER

VERMES Microdispensing – GENMA, 솔더 페이스트를 극미세하게 토출 가능하게한 획기적 제트 디스펜싱 솔루션

혁신적인 마이크로 디스펜싱 시스템의 설계 및 제조를 선도하는 VERMES Microdispensing 과 세계적으로 유명한 고품질 솔더 페이스트를 제조하는 GENMA의 최근 협업으로 전자 제품 제조에서 요구되는 매우 적은 양의 솔더 페이스트 적용을 위한 빠르고 안정적인 프로세스가 최근 가능해졌다.

솔더 페이스트 디스펜싱의 주요 적용 영역 중 하나는 PCB에 전자 부품을 실장하는 공정이다. 또 다른 주요한 영역은 모듈 패키징에서의 사용이다. 이 공정 모두 최고의 디스펜싱 품질과 안정적인 공정 조건을 필요로 한다.



현재 시장에 존재하는 많은 시스템들은 고속에서 작은 액적 사이즈를 요구하는 시장의 요구를 충족시키지 못한 채 기존기술에 의존하고 있다. 반면 VERMES Microdispensing 시스템은 비접촉 방식으로 용액이 고속, 고정밀로 토출될 수 있도록 하는 제트 밸브를 기반으로 한다.

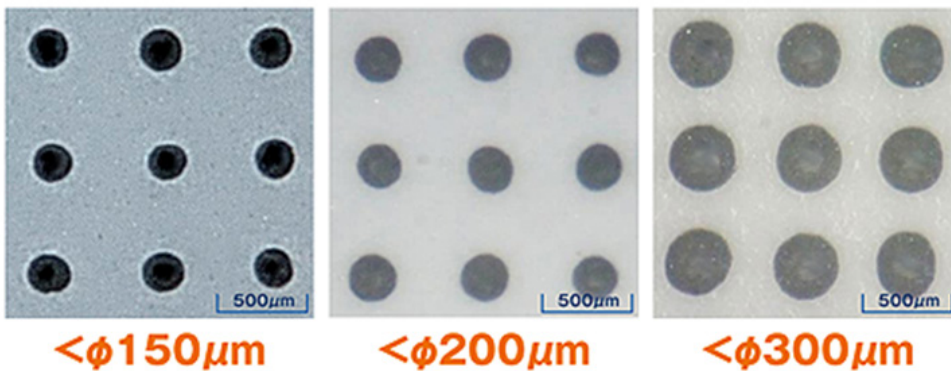
GENMA Europe의 CEO 인 Stefan Komenda 는 “ GENMA는 고객을 위해 지속적으로 개선점 및 새로운 기술 솔루션을 찾고 있다. VERMES Microdispensing과의 협업을 통해 솔더 페이스트 토출에 있어서 현재의 기술적 난제를 해결하는 뛰어난 솔루션을 제공할 수 있게 되었다. GENMA의 winDot 솔더 페이스트는 자동화된 생산 공정에서 130µm의 작은 액적 크기로 일관되고 안전하게 도포될 수 있다”고 말했다.

VERMES Microdispensing의 CEO 인 Juergen Staedtler는 “혁신적인 액추에이터 원리인 DST

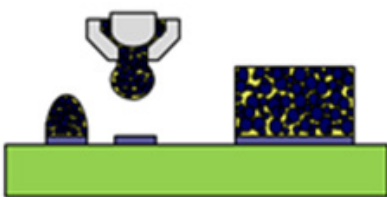
(Dynamic Shockwave Technology) 기술을 기반으로 하는 VERMES Microdispensing의 MDS 1560시스템의 장점이 GENMA winDot 솔더 페이스트와 결합되어 고객에게 매우 작은 액적 사이즈에서도 최적의 솔더 페이스트 디스펜싱 결과를 제공할 것이다.” 라고 덧붙였다.

VERMES Microdispensing의 MDS 1560 시스템은 디스펜싱 로봇 및 스크린 프린터와 같은 다양한 기계 플랫폼에 쉽게 통합될 수 있다.

고품격 디자인과 향상된 기능은 전자기기의 지속적 소형화를 요구한다. GENMA의 winDot 솔더 페이스트와 최적화된 디스펜싱 특성을 갖춘 새로운 VERMES MDS 1560 시스템이 결합되면 고속에서도 절대적으로 신뢰할 수 있는 프로세스로 작은 액적을 분사할 수 있다. 속도와 액적 크기 외에도 신뢰성이 특히 중요하다. 이 새로운 제팅 공정은 연속적이고 최상인 결과를 제공하는 솔루션을 제공한다. 이 밸브는 작업자의



VERMES MDS 1560 Micro Dispensing System 으로 도포된 GENMA winDot 솔더 페이스트의 다양한 액적 크기



모듈 패키징에서 요구되는 작은 액적 크기들



스크린 프린팅 공정과 결합된 작은 패드를 위한 제트 디스펜싱

주의 없이도 1 백만 개 이상의 액적을 연속으로 제팅할 수 있다.

전자 제품 제조에서 이 솔루션은 가장 작은 액적 크기의 솔더 페이스트 디스펜싱을 쉽게 수행하면서 기판의 밀도를 높일 수 있다. GENMA winDot 솔더 페이스트는 현재 사용중인 부품 중 가장 작은 칩 부품인 01005를 위한 패드에 제팅될 수 있다.

프로토타이핑 및 소규모 생산에서 GENMA winDot 솔더 페이스트와 결합된 VERMES Microdispensing System MDS 1560은 스텐실 프린팅보다 훨씬 더 생산적이다.

대량생산에서 이 솔루션은 솔더 페이스트 데포를 채우거나 추가하는데 이상적이다.

연성회로기판 (flexible PCBs) 및 3D-MID (3-Dimensional Molded Interconnected Devices production) 와 같이 작은 솔더

페이스트 데포를 프린팅할 수 없는 경우 이 시스템 솔루션은 가장 빠르고 정확하게 솔더 페이스트를 도포할 수 있는 방법을 제공한다.

의심할 여지없이 제팅 기술은 니들 디스펜싱이나 Pin to Pin 방식보다 빠르고 지속적으로 정확한 결과를 제공한다.

정밀도가 높을수록 현재 사용되는 솔더 페이스트 도포 방법에 비해 생산 수율을 크게 증가시킨다. 높은 신뢰성과 함께 고속으로 도포된 작은 액적 크기는 PoP 모듈, CSP 모듈, 3D 적층보드 및 RF 차폐 장착과 같은 모듈 패키징에 큰 장점을 제공한다.

VERMES Microdispensing GmbH
Rudolf-Diesel-Ring 2
83607 Holzkirchen | Germany

+49 (0) 8024 6 44 0 | +49 (0) 8024 6 44 19

sales@vermes.com | www.vermes.com

Germany
+49 (0)8024 644 - 0
info@vermes.com

China
+86 (0)592 7257233
info@vermes.com

USA
+1 408 520-2555
america@vermes.com

Korea
+82 (0)32-246-1500
korea@vermes.com

Malaysia
+60 4 358 0996
info@vermes.com

